

2012年度
上期

株主通信

2012年4月1日から2012年9月30日まで



ごあいさつ

**株主の皆様には、格別のご高配賜り厚く御礼申し上げます。
2012年度上期株主通信をお届けするにあたり、謹んでご挨拶
申し上げます。当上期の事業概況につきましてご報告申し上げます。**

代表取締役社長 赤尾 泰



当上期の連結売上高は、前年同期と比べ9.1%減少し4,094億円となりました。欧州や中国を中心とした市況停滞の継続による需要軟化に加え、円高が進行したことなどが、売上減の主な要因であります。当社の主力事業である半導体売上高についても、前年同期と比べ7.1%減少し3,736億円となりました。

当上期の連結営業損益は233億円の損失で、前年同期と比べ59億円の改善となりました。売上高が減少したものの、研究開発費の効率化や販売費及び一般管理費の削減を進めたことなどによるものです。また、連結経常損益は244億円の損失となりました。受取保険金などの営業外収益を44億円計上した一方、支払利息などの営業外費用を56億円計上した結果、営業外損益が11億円の損失となったことによるものです。連結四半期純損益については、1,151億円の損失となりました。主に国内における早期退職優遇制度の実施に伴い事業構造改善費用を含

む特別損失を906億円計上したことなどによるものです。

今後の当社を取り巻く経営環境としては、欧州の債務・金融問題の長期化や、中国をはじめとする新興国経済のさらなる減速に加え、日中関係の不透明化による需要への影響などが顕在化しつつあります。そのため、本年度の通期連結業績予想につきましては、当初計画(2012年8月2日公表)を据え置いておりますが、上記のようなリスク要因を見極め、今後当社の業績に与える影響を慎重に精査する必要があると考えております。こうした分析を進め、今後業績予想の修正が必要となった場合には速やかに公表いたします。

■ 配当未実施のお詫び

中間配当の実施につきましては、誠に遺憾ではございますが、連結業績が四半期純損失を計上する状況であることから、見送らせていただくことといたしました。また、期

末配当につきましても、本年度の連結当期純損益が損失を計上する見込みであることから、これを見送らせていただく予定であります。株主の皆様のご期待に添えず、深くお詫び申し上げます。今後とも全社を挙げて、配当の再開に向け、業績および財政状態の改善に努めてまいります。

■ 強靱な収益構造の構築に向けて

当社は、2010年4月1日付の統合以降、①資材の共通化による資材費用の低減、技術資産の統合等による研究開発費の効率化、販売チャネルの絞り込み、ITシステム統合等による販売管理費の低減といった「統合シナジーの実現」、②津軽工場、ローズビル工場の売却を含む当社生産拠点の再編、事業の選択と集中、重複業務の削減を目的とした2011年3月末での約1,500名の早期退職といった「構造対策の実行」を柱に掲げ、この間、事業に甚大な影響をもたらした東日本大震災からの復旧を果たすとともに、統合後の2年間で約20%の固定費削減を実現する等、各種施策を着実に実行してまいりました。

しかしながら、欧州財政問題の再燃や中国経済の減速、長引く円高や日本国内の民生機器市場の急変といった世界経済や日本市場の環境変化に対応するためにはさらなる施策が必要であると考え、本年7月3日には、国内生産拠点のさらなる大幅な再編と早期退職優遇制度の実施を柱とする「強靱な収益構造の構築に向けた諸施策の方向性について」を公表し、機動力のある費用構造への変

革と業績の回復へ向けた不退転の決意をお示しいたしました。早期退職優遇制度につきましては、本年10月16日に公表いたしましたとおり、7,446名の応募があり、応募者は本年10月31日をもって全員退職いたしました。また、国内生産拠点の再編につきましては、本年10月12日に公表いたしましたとおり、株式会社ルネサスハイコンポーネンツ(青森工場)等をアオイ電子株式会社へ譲渡することについて合意いたしました。

さらに、本年9月28日に公表いたしましたとおり、当社の主要株主および主要取引銀行から計970億円の新規資金調達を行った他、主要取引銀行をアレンジャーとして、長期安定資金確保のため、短期借入金を長期化する総額1,611億円のシンジケートローン契約を締結する等、足元の構造対策を確実に実行するために必要となる当面の資金を確保いたしました。

当社は、今後全社一丸となって、売上規模の回復と成長に取り組むとともに、強靱な収益構造の構築に向けて構造対策を推進し、固定費の大幅削減による機動的な費用構造と収益力ある事業ポートフォリオへの変革を加速してまいります。これにより、2014年度において、営業利益率10%以上を達成できる企業となるよう、全力を尽くしてまいりますので、引き続き変わらぬご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

スマート社会の進展に向けた

当社が半導体製品を提供する既存分野・アプリケーションのネットワーク化が進み、
エコ、安心・安全、便利・快適を実現する「スマート社会」が到来

スマート社会



スマートカー



スマートグリッド



スマートファクトリー



スマートビルディング



スマートホーム



スマートヘルスケア

エコ、安心・安全、便利・快適を実現

ネットワーク化



自動車



産業



家電



通信



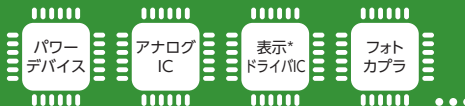
健康機器・医療

提供

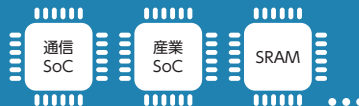
マイコン事業



アナログ&パワー半導体事業



SoC事業



世界シェアNo.1のマイコン事業を軸に、
マイコンと相乗効果の高いアナログ&パワー半導体事業を強化。
SoC事業については選択と集中により事業ポートフォリオを最適化。

* 中小型パネル用

ルネサスの事業戦略

スマート社会の実現への貢献

先進国における持続的な成長と新興国の急速な経済発展に伴い、電力消費量は世界的に増加の一途をたどっています。その中で、限りあるエネルギー資源の効率的な活用が最重要課題となっており、いわゆるスマート社会への動きが加速しています。

スマート社会の実現に向けた動きは、環境の保護や利便性の向上といった観点に加え、東日本大震災の発生に伴う世界的なエネルギー供給の見直し変化や、新興国における急激な電力需要増を背景に、先進国と新興国の双方にて同時進行していくものと考えられます。当社グループでは、汎用マイコンと車載マイコン、製品ラインアップとしてもローエンドからハイエンドまで、すべての分野において世界No.1シェアのマイコンを幅広く有しています。これらマイコン製品を中心に、スマート社会の実現への取り組みを推進することにより、収益力の向上を図ります。



海外・新興国市場向けへの取り組み強化

今後の半導体市場の成長は、中国をはじめとする新興国市場が牽引すると考えられており、当社グループの競争力向上のためには、海外・新興国市場向けへの取り組み強化が欠かせない状況です。当社グループでは、近年、中国市場における取り組みとして、現地のニーズに基づいて、現地で設計、開発を促進する体制を強化した結果、同市場における当社グループのマイコンシェアが拡大するなど、今後確固たるポジションを構築するための基盤ができました。こうした現地に適合した事業のサイクルを、今後成長が見込まれる他の新興国市場へ展開することにも着手しており、インド市場における支店の開設、ブラジル市場における販売支援会社の設立など、事業拡大へ向けた取り組みを強化しています。

ブラジル・サンパウロ市に「ルネサス エレクトロニクス・ブラジル・サービス」を設立

(2012年2月発表)

近年、ブラジルは日系や欧米系メーカーの進出に加え、自動車関連、産業機器、民生機器分野を中心に地場メーカーの成長も著しく、その半導体市場は高い成長が見込まれています。今回のブラジル拠点設立によりルネサスは、地場メーカーを中心とするお客様へのきめ細かな技術サポートおよびマイコンとアナログ&パワー半導体製品のキットソリューションの拡販に注力することで、ブラジルにおけるシェア拡大を図ります。



マイコン事業におけるTSMCとの協業関係を拡大

90nmマイコンの製造委託に引き続き、 40nmマイコンを共同開発し、製造委託へ

2012年5月、当社と台湾積体回路製造（以下TSMC）は、次世代の自動車や家電などの民生機器に使われるマイコンの製造にあたり、40nmの組込みフラッシュメモリのプロセス技術分野で協業関係を拡大することに合意しました。既に当社は90nmマイコンのTSMCへの製造委託を始めていますが、今回、新たに40nm以降のマイコンに関しても製造を委託し、マイコンで世界トップシェアのルネサスが保有する高信頼、高速読み出し可能な「MONOS*」技術、お客様に対する質の高い技術サポートと、TSMCの先端CMOSプロセス技術、フレキシブルな生産能力を結びつけることにより、両社はマイコンプラットフォームとその生産に必要な先端技術を共同開発し、マイコン市場をリードします。

今回の協業により、当社はコスト効率と高信頼性を両立させながら、40nmプロセスのフラッシュマイコンを実現できます。

●協業概要



* MONOS：Metal(メタル)－Oxide(酸化膜)－Nitride(窒化膜)－Oxide(酸化膜)－Silicon(シリコン)の略称。

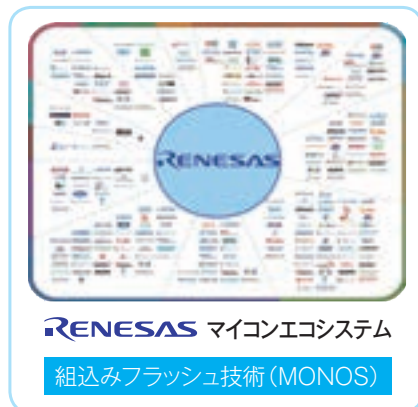
マイコンの「エコシステム*」構築を共同で推進

当社はコアコンピタンスのマイコンにおいて、ツールベンダー、ソフトウェアベンダー、ファウンドリなど700社以上からなる世界規模のエコシステムを有しています。当社マイコンをベースに、企業の枠を越えて互いの技術や資本を生かしながら協調して活動し、マイコン業界全体として共存共栄を目指しています。一方、TSMCは、SoCも含めた豊富なエコシステムを有しています。本協業にて両社がそれぞれのエコシステムを持ち寄ることで、共同開発成果としてのMONOS混載マイコンプラットフォームを含む巨大なエコシステムが誕生します。今後、両社は、プラットフォームを世界中の半導体サプライヤに広く提供します。また、新エコシステムをマイコンのみならずSoCの領域に拡大するとともに、従来のSoC市場に包含されている、潜在的なフラッシュマイコンの市場ニーズおよび一層の顧客基盤の開拓を図り、マイコン市場を拡大させていきます。

*エコシステムとは？

本来は、生物とその環境の構成要素を「システム」と捉えた「生態系」を意味しますが、ここでは、ある業界に関わる複数の企業が協調して活動し、企業の枠を越えて、業界全体として共存共栄する仕組みのことを指します。

●エコシステム



巨大なエコシステム

マイコンプラットフォーム

組込みフラッシュ技術 (MONOS)

先端CMOS プロセス技術
フレキシブルな生産能力



強靱な収益構造に向けて、構造対策を推進

昨年の東日本大震災・タイ洪水等の自然災害に加え、欧州や中国を中心とした世界経済の停滞感などにより、当社の事業環境は急激に変化しており、当社の売上高は大きな影響を受けています。そのため、業績の回復を急ぐべく、当社は更なる収益基盤の強化に向け、生産効率化や財務基盤の強化をより一層加速しています。その一環として、2012年7月に、国内生産拠点の再編と人的合理化を主軸とした構造対策を発表しました。国内生産拠点は、注力分野向けの生産体制を維持・強化する一方で、事業の選択と集中に伴い生産負荷が減少した生産拠点は縮小、または譲渡・集約します。その結果、3年以内をめどに国内前工程は2拠点・5ラインを削減し、7拠点・9ラインへ、国内後工程は7拠点を削減し、2拠点となる見込みです。生産構造の最適化と並行して、早期退職優遇制度を実施しました。同制度に対する応募者は7,446名となり、2012年10月末に応募者は全員退職しました。これによる人件費の削減効果は年間約530億円を見込んでいます。



青森県の2工場を譲渡

当社グループでは、自社前工程生産については、ウェハの大口径化・プロセスの微細化を進め、自社後工程生産については、海外生産シフトを加速し、生産効率の改善を推進しています。

この方針の下、全ての生産拠点において様々な施策の検討を進めており、前工程については、2012年7月1日に、当社の100%子会社である(株)ルネサス北日本セミコンダクタの津軽工場(所在地: 青森県五所川原市)を富士電機(株)に譲渡しました。

また、後工程については、2012年10月12日に、当社の100%子会社である(株)ルネサス東日本セミコンダクタが保有する(株)ルネサスハイコンポーネンツ(所在地: 青森県北津軽郡鶴田町)の全株式および同社の受託生産事業に関わる、ルネサス東日本セミコンダクタの営業人員を含む営業事業をアオイ電子(株)に譲渡することを発表しました。本件譲渡は、2013年1月1日に完了する予定です。

ルネサスのコアコンピタンス

世界 No.1 マイコンの競争力の源泉 3つのマイコンコアと組み込みフラッシュメモリ技術

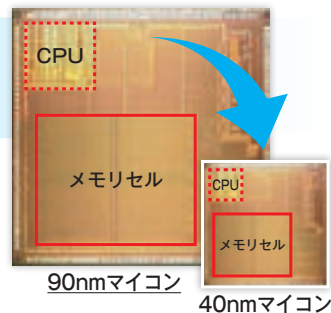
当社グループが誇る世界 No.1 マイコンの競争力の源泉は、成長市場に最適な3つのマイコンコアと、マイコンに組み込むフラッシュメモリ技術にあります。

■ 3つのマイコンコア

2年前の統合当初、マイコンコアは5つありましたが、現在は、ローエンド、ミッドレンジ、ハイエンドそれぞれの分野に1つずつ、計3コアに集約し、設計、開発、営業リソースを集中させています。これら3コアは、フルラインアップ、低消費電力、高信頼性という共通した強みを持っています。「RL78」は主に新興国市場、「RX」は主にスマート社会市場、「RH850」は主に自動車向けと、今後成長する市場を中心とした幅広いアプリケーション向けにそれぞれ提供し、最適なソリューションを提供します。

	ローエンド	ミッドレンジ	ハイエンド
マイコンコア			
狙う成長市場	新興国市場 小規模システム向け	スマート社会市場 インバータ機器など	自動車 エンジン制御など
強み	フルラインアップ ● 各アプリケーションに最適なメモリサイズ・パッケージを提供		
	低消費電力 ● レモン1個で、超低電力マイコンの動作を実証 ● RL78/RX/RH850で業界最小の消費電力を実現 		
	高信頼性 ● 不良率0.4ppm(1 / 250万個の不良品)を実現 ● 高信頼性に対し、自動車/電装メーカーからの表彰・感謝状		

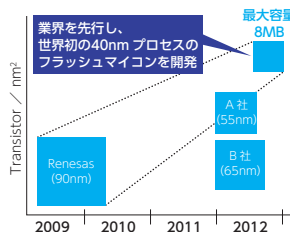
世界最小メモリセル



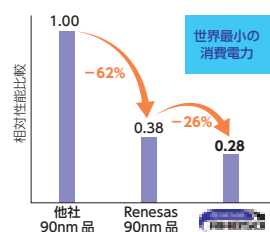
■ 組み込みフラッシュメモリ技術

当社グループは、「MONOS」構造のフラッシュメモリ技術を独自開発し、マイコンに組み込んでいます。早くから高信頼性、高集積化要求のトレンドを見通し、微細化が比較的容易な「MONOS」構造のフラッシュメモリを150nmマイコンに採用し、フラッシュマイコンとして自動車、民生、産業の幅広い分野で展開してきました。2007年には業界で初めて90nmフラッシュマイコンのサンプル出荷を開始し、2011年末には、業界で初めて40nmのマイコン内蔵用フラッシュメモリIPを開発しました。40nm採用により、現行の90nmと比べて、1/4の世界最小メモリセルを実現し、大容量プログラム格納のみならず、高信頼性・高速動作・低消費電力という特長をより一層強化しています。40nmプロセスは、RH850マイコンに適用し、今後ますます高信頼性・高速動作・低消費電力が要求される自動車に対して展開していきます。

フラッシュマイコンのサンプル時期



フラッシュマイコンの消費電力



マイコン事業

当社の収益の基盤となる事業として、
さらなる売上の拡大を目指します。



■ 主な製品

マイクロコントローラ

■ 主なアプリケーション

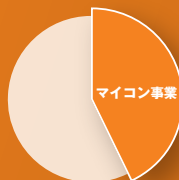
自動車、産業機器、民生用電子機器、パソコン周辺機器

(2012年4月～9月)

売上高 **1,564億円**

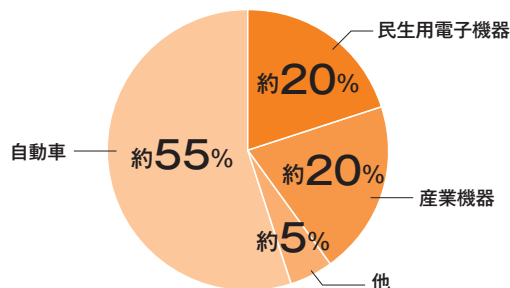
半導体売上高
構成比

42%



■ 上期売上高概況

当上期におけるマイコン事業の売上高は前年同期と比べ5.1%減少し、1,564億円となりました。主に自動車向けマイコンの売上高が増加したものの、欧州や中国を中心とした市況停滞の継続による需要軟化により、産業機器向けやパソコン周辺機器向けマイコンの売上高が減少したことによるものです。



事業別 NEWS

40nm 採用のハイエンド統合マイコン第一弾製品「RH850/F1x」

当社は、業界最先端の40nmプロセスを採用したフラッシュメモリ内蔵マイコン「RH850ファミリ」を製品化しました。RH850は、2010年4月の統合前の両社が自動車市場で長年にわたり培ってきた高い技術と信頼性、実績を結実した、ハイエンドの自動車向けマイコンです。2012年9月に、第一弾製品として、自動車のボディ制御向けに「RH850/F1xシリーズ」を発表し、2013年春からのサンプル出荷を予定しています。40nm採用により実現した、低消費電力かつ高性能という特長を活かし、同製品をハイブリッドカー、電気自動車など次世代車に要求されるシステムに対して幅広く提供していきます。



アナログ&パワー半導体事業

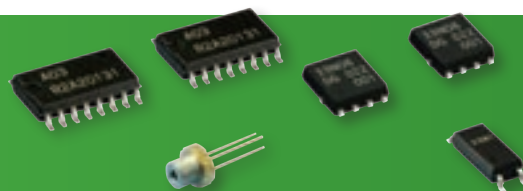
当社の事業の拡大・安定のため、
マイコン事業との相乗効果の高い
アナログ&パワー半導体事業の売上拡大を目指します。

(2012年4月～9月)

売上高 **1,228億円**

半導体売上高
構成比

33%



■ 主な製品

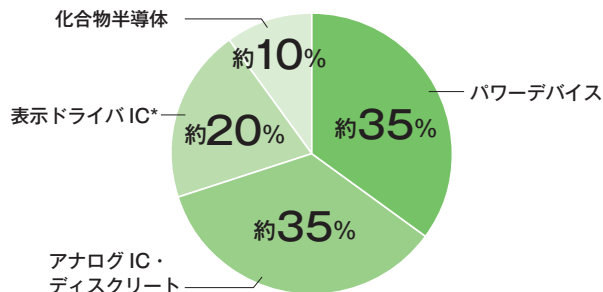
パワー MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)、ミックスドシグナル IC、IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)、ダイオード、小信号トランジスタ、表示ドライバ IC、化合物半導体

■ 主なアプリケーション

自動車、産業機器、民生用電子機器、パソコン周辺機器

■ 上期売上高概況

当上期におけるアナログ&パワー半導体事業の売上高は前年同期と比べ5.6%減少し、1,228億円となりました。自動車向けのパワー半導体や中小型パネル向け表示ドライバICの売上高は増加したものの、大型パネル向け表示ドライバIC事業の撤退決定に伴い、パソコンおよび液晶テレビ向け表示ドライバICの売上高が減少しました。また、マイコンと同様に欧州や中国を中心とした景気停滞感の継続により、民生用電子機器向けアナログICやディスクリートの売上高が減少したことによるものです。



* 中小型パネル向けを中心とする。

事業別 NEWS

NFC方式のワイヤレス給電システム ソリューションを業界で初めて提供

当社は、2012年9月に、近距離無線通信規格「NFC」を採用した、業界初のワイヤレス給電向けシステムソリューションを発表しました。ワイヤレス給電は、電源ケーブルを使わずに無線で電子機器を充電できることから、スマートフォンをはじめ今後ヘルスケアなどの幅広い民生機器での普及が期待されています。当社は、NFCマイコン「RF20」と送受電IC、周辺の汎用品(パワー半導体等)までを含めたトータルキットを提供していきます。当社は、かねてより、シェアNo.1のマイコンとアナログ&パワー半導体製品のシナジーを追求してきましたが、今回のソリューションはその成果の一つとなります。



SoC事業

注力分野へリソースを集中投下し、
強い半導体ソリューションを提供します。



売上高

(2012年4月～9月)

893億円

半導体売上高
構成比

24%

SoC事業

■ 主な製品

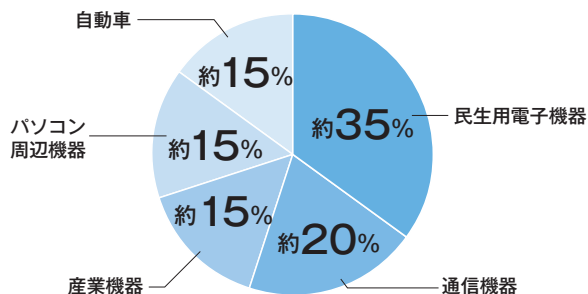
ASIC (Application Specific Integrated Circuit)、
ASSP (Application Specific Standard Product)

■ 主なアプリケーション

民生用電子機器、通信機器、産業機器、パソコン周辺機器、自動車

■ 上期売上高概況

当上期におけるSoC事業の売上高は前年同期と比べ14.9%減少し、893億円となりました。主にカーナビゲーションなどの自動車向け半導体の売上高が増加したものの、パソコン周辺機器向け半導体や携帯端末向けの半導体の売上高が減少したことに加え、新製品開発を中止したホームマルチメディア向け製品の売上高が減少したことなどによるものです。



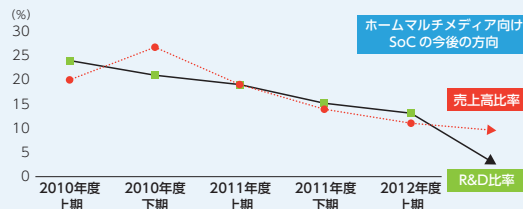
事業別 NEWS

ホームマルチメディア向け SoCの新製品開発中止

当社は、SoC事業において、製品寿命が短い分野の開発を絞り込み、不採算製品を整理してまいりましたが、2012年8月に、テレビなど民生用デジタルAV機器を含むホームマルチメディア関連の新製品開発を全面的に中止することを決定しました。既存品の販売サポートは今後も責任を持って継続しますが、新規の製品開発およびR&D活動を停止することで、収益改善を図ってまいります。

● SoC全体の中でホームマルチメディア製品の比率

※2012年3月に事業譲渡したハイパワーアンプ事業は除く



■ 連結貸借対照表

	前年度末 (2012年3月31日)	当上期末 (2012年9月30日)
総資産	8,582 億円	7,483 億円
純資産	2,265 億円	1,068 億円
自己資本比率	25.4%	13.0%

■ 連結損益計算書

	前上期 (2011年4月1日から 2011年9月30日まで)	当上期 (2012年4月1日から 2012年9月30日まで)
売上高	4,506 億円	4,094 億円
半導体売上高	4,022 億円	3,736 億円
その他売上高	484 億円	358 億円
営業損益	△ 292 億円	△ 233 億円
経常損益	△ 333 億円	△ 244 億円
四半期純損益	△ 420 億円	△ 1,151 億円
米ドル為替レート	81 円	80 円
ユーロ為替レート	115 円	102 円

■ 連結キャッシュ・フロー計算書

	前上期 (2011年4月1日から 2011年9月30日まで)	当上期 (2012年4月1日から 2012年9月30日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 211 億円	△ 135 億円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 326 億円	△ 205 億円
フリー・キャッシュ・フロー	△ 537 億円	△ 340 億円

(注) 億円未満を四捨五入して表示しております。



ルネサスバドミントン部

ロンドンオリンピックにて躍動！ 日本バドミントン界初の銀メダルを獲得

7月27日に開幕し、数々の感動を与えたロンドンオリンピックにおいて、バドミントン部から藤井瑞希・垣岩令佳ペア、末綱聡子・前田美順ペアが出場しました。末綱聡子・前田美順ペアは惜しくも予選敗退となったものの、藤井瑞希・垣岩令佳ペアは決勝の舞台まで上り詰め、日本バドミントン界において初めての銀メダル獲得を達成することができました。



左：垣岩令佳選手、右：藤井瑞希選手
写真提供：PHOTO KISHIMOTO



● ぜひチームのホームページもご覧下さい。
<http://sports.renesas.com/badminton>



ルネサス エレクトロニクス高崎 女子ソフトボール部

全日本総合選手権大会で2年連続の優勝 世界女子ソフトボール選手権大会で金メダル

2012年9月21日から24日までの4日間で行われた第64回全日本総合選手権大会で、接戦を制し、2年連続15度目の優勝を果たすことができました。

また、日本代表として上野由岐子、峰幸代、大久保美紗、岩渕有美、関友希央が選出され、7月にカナダ・ホワイトホースで開催された第13回世界女子ソフトボール選手権大会で42年ぶりの悲願の金メダル獲得に貢献しました。



全日本総合選手権大会で優勝



● ぜひチームのホームページもご覧下さい。
<http://sports.renesas.com/softball>

■ 会社概要

商号
ルネサスエレクトロニクス株式会社

設立
2002年11月1日
(2010年4月1日ルネサス エレクトロニクス株式会社として営業開始)

資本金
1,532億円

主な事業
各種半導体に関する研究、開発、設計、製造、販売およびサービス

従業員数(連結)
約41,900名

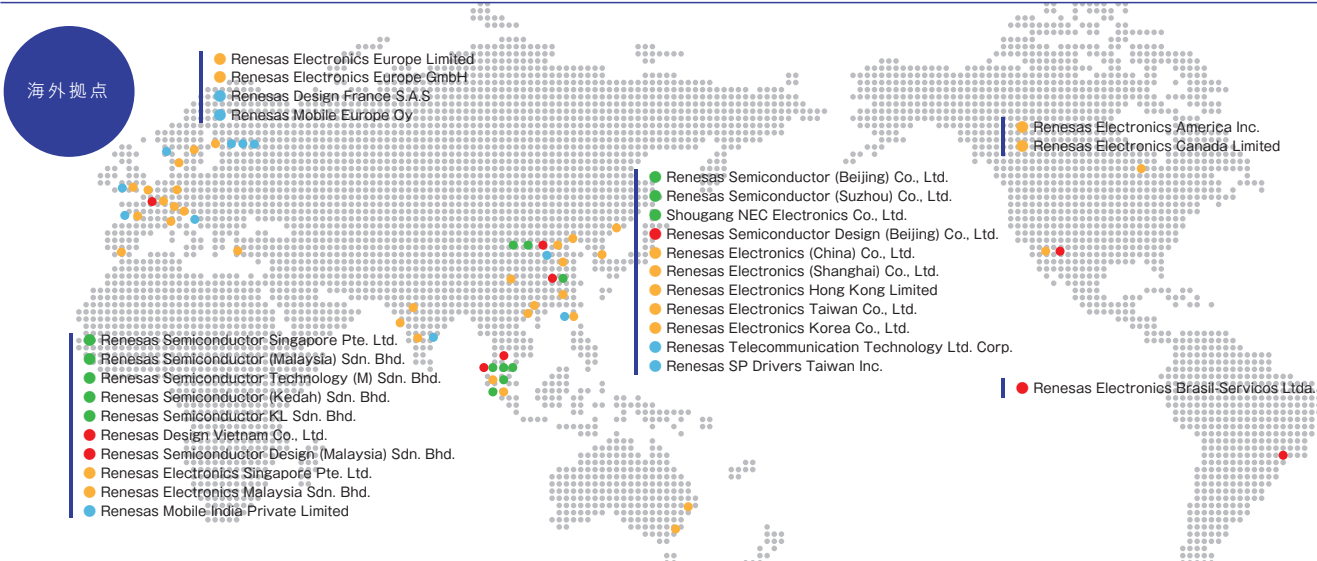
本店所在地
神奈川県川崎市中原区下沼部 1753 番地

本社事務所
東京都千代田区大手町 2-6-2 (日本ビル)

■ 役 員

代表取締役社長	赤 尾 泰
代表取締役執行役員専務	加 藤 正 記
取締役執行役員常務	矢 野 陽 一
取締役執行役員	岩 熊 省 三
取締役執行役員	水 垣 重 生
取締役執行役員	鶴 丸 哲 哉
取締役(非常勤)	古 川 享
取締役(非常勤)	山 村 雅 宏
取締役(非常勤)	市 毛 正 行
取締役(非常勤)	山 本 徳 男
監査役	西 淳 一 郎
監査役	福 田 和 樹
監査役(非常勤)	山 川 洋 一 郎
監査役(非常勤)	清 水 芳 信
監査役(非常勤)	北 松 義 仁

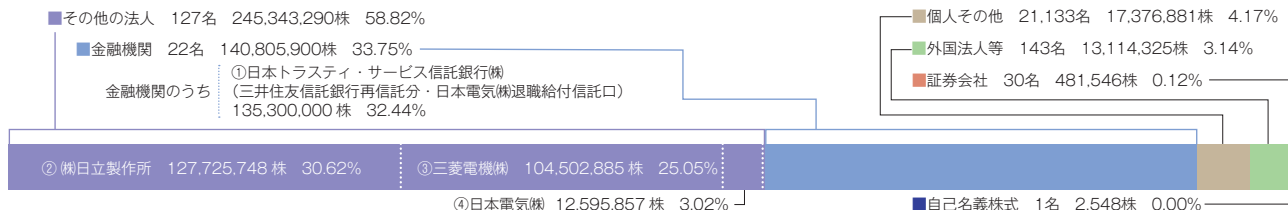
■ グローバルネットワーク



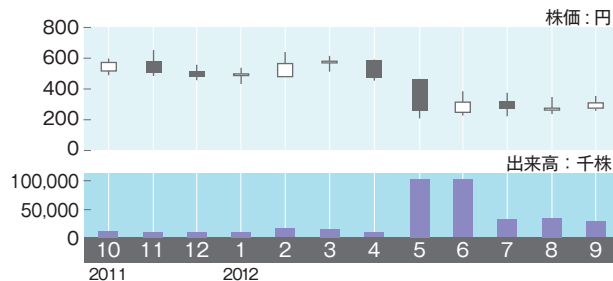
株式の状況

発行可能株式総数	800,000,000 株
発行済株式の総数	417,124,490 株
株 主 数	21,456 名

株主構成



株価チャート (2011年10月1日～2012年9月30日)



国内拠点

- ルネサス北日本セミコンダクタ
- 羽黒電子
- 北海電子
- ルネサス山形セミコンダクタ
- ルネサス ハイコンポーネンツ

- ルネサス柳井セミコンダクタ
- ルネサス関西セミコンダクタ
- ルネサス セミコンダクタ九州・山口
- ルネサス九州セミコンダクタ
- ルネサス セミコンダクタ エンジニアリング
- ルネサス デザイン
- ルネサス北伊丹エンジニアリングサービス

- 製造・製造支援
- 設計・開発・応用技術
- 販売
- 事業会社・その他

- ルネサス エレクトロニクス
- ルネサス那珂セミコンダクタ
- ルネサス東日本セミコンダクタ
- ルネサス甲府セミコンダクタ
- ルネサス エレクトロニクス
- ルネサス ソリューションズ
- ルネサス マイクロシステム
- ルネサス高崎エンジニアリングサービス
- ルネサス武蔵エンジニアリングサービス
- ルネサス エレクトロニクス販売
- ルネサス モバイル
- ルネサス エスピードライバ

■ 株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	事業年度の末日の翌日から起算して3か月以内
基準日	定時株主総会 毎年3月31日 期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日
単元株式数	100株
株主名簿管理人および 特別口座の口座管理機関	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
同事務取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
郵便物送付先	〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
電話照会先	フリーダイヤル 0120-176-417
インターネット ホームページURL	http://www.smtb.jp/personal/agency/
上場証券取引所	東京証券取引所

【特別口座について】

株券電子化前に「ほふり」(株式会社証券保管振替機構)をご利用されていなかった株主様には、株主名簿管理人である左記の三井住友信託銀行株式会社に口座(特別口座といいます。)を開設しております。特別口座についてのご照会および住所変更等のお届出は、左記の電話照会先をお願いいたします。

IR サイトのご紹介

当社のIRサイトは、株主の皆様当社をより理解していただくため、IRサイトの見やすさ、各資料へのアクセスのしやすさを重視した作りになっております。

また、「半導体ミニ知識」のコーナーにおいて、半導体の基礎知識に関するご紹介をしております。

ぜひ、ご覧下さい。

「投資家の皆様へ(IR情報)」のアドレス

<http://japan.renesas.com/ir/>

注目トピックス

最新資料を
一括掲載

IR ニュース

半導体ミニ知識

RENESAS

ルネサス エレクトロニクス株式会社
(Renesas Electronics Corporation)

〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-2 (日本ビル)
TEL. 03-5201-5111